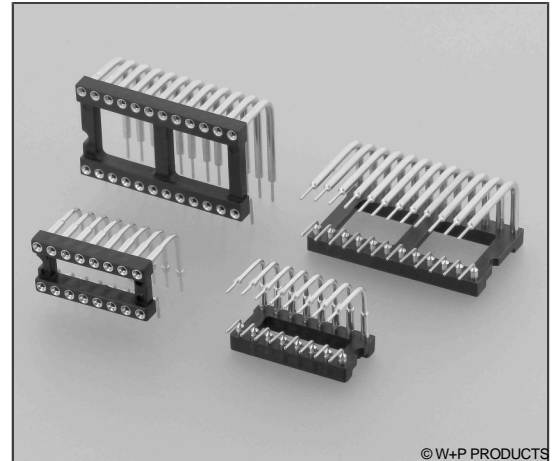


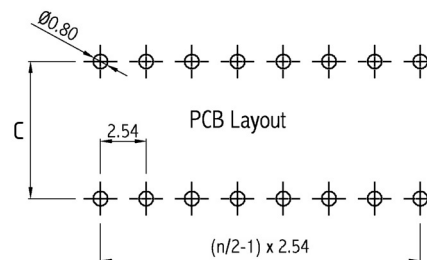
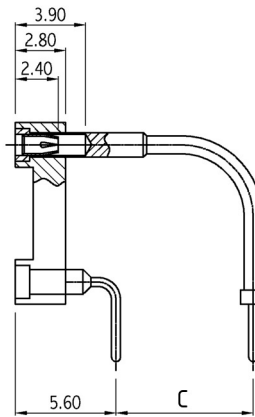
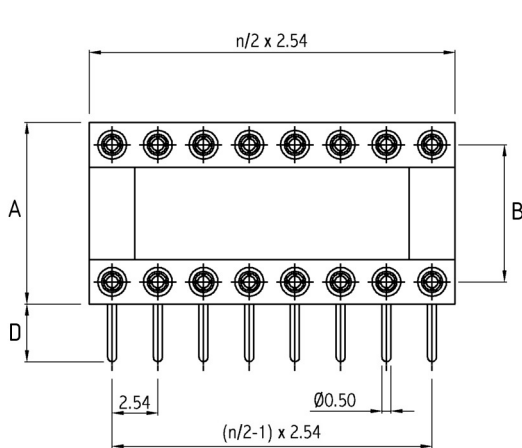
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40–0,56mm
oder für Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
*Accepts Ø0.40–0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.*



Series 181	Contacts* 16 10 =====> 04/06/08/10/14/16 => 18/20/22/24/28 =====	Type* 7 2 A=7.6 B=5.08 C=5.08 D=3.2mm 7 A=10.1 B=7.62 C=2.54 D=3.2mm 3 A=10.1 B=7.62 C=7.62 D=3.2mm Type 7: Geschlossener ISK Type 7: Closed frame	Sleeve Plating 50 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	Clip Plating* 00 00 Vergoldet Gold plated 30 0,75µm Au
Series 181	Contacts* 24 16/24/28/32/36 40/42/48/50/52	Type* 6 6 A=17.7 B=15.24 C=7.62 D=4.2mm	Sleeve Plating 50 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	Clip Plating* 00 00 Vergoldet Gold plated 30 0,75µm Au

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

